**COMUNICADO DE PRENSA**

División de envolventes

**Individual y estandarizado: reordenación del surtido de envolventes de 19" de BOPLA**

* Se reestructura la cartera de subracks y sistemas modulares de 19"
* Todo de una mano, de la placa frontal a la caja para armarios pequeños
* Gama de servicios para la cadena completa del proceso, del desarrollo al embalaje individual

**Bünde, 30 de marzo de 2023. Estándar son solo las dimensiones: con ocasión del lanzamiento del nuevo catálogo de productos, la empresa Bopla Gehäuse Systeme GmbH reestructura su cartera de envolventes y productos de 19 pulgadas. Los sistemas integrados, específicos para cada cliente, se desglosan en cajas encajables y para sobremesa, cajas para armarios pequeños como soporte para subracks de 19 pulgadas y placas frontales. Por lo demás, BOPLA fabrica envolventes especiales para tarjetas PCB divergentes de la versión normalizada. Si lo desean, los ingenieros de desarrollo tienen a su disposición un paquete de servicios para todas las soluciones ofrecidas, que van desde la planificación, la elaboración de muestras y la producción en serie hasta el embalaje. Todo de una misma fuente. BOPLA satisface con ello las exigencias crecientes de este mercado.**

Una placa frontal con impresión específica. Una caja para sobremesa apta para su integración en un armario de mando. Una caja de 19 pulgadas para tarjetas PCB de dimensiones especiales, distintas de las tarjetas normalizadas europeas. O también un embalaje específico conforme con las preferencias del cliente. Las expectativas a los subracks de 19 pulgadas y a otros sistemas para integración de componentes son cada vez más individuales. Ya no basta con ofrecer una envoltura robusta: en el desarrollo es preciso tener en cuenta un número creciente de detalles específicos de equipamiento. De ahí la importancia de trabajar con un socio competente en la producción de subracks a medida, comenta Olaf Kleineberg, gerente de producto para cajas de 19 pulgadas en BOPLA: “Partimos del estándar normalizado para envolventes de 19 pulgadas y producimos sistemas a medida para cubrir una demanda específica. Gracias al extenso abanico de productos y al elevado porcentaje de producción propia de los componentes, podemos ofrecer productos singulares de una sola mano.”

**Siempre en conformidad con la norma DIN EN 60297-3-101**

A la hora de integrar sus sistemas electrónicos en las envolventes de 19 pulgadas de BOPLA, los técnicos de desarrollo pueden elegir entre productos metálicos y de plástico. Todos los componentes están normalizados según DIN EN 60297-3-101. La gran diversidad de diseños y dimensiones, así como la amplia gama de accesorios, son la clave de la elevada flexibilidad en campos de aplicación muy diferentes. La cartera de productos incluye tanto ejecuciones estándar como versiones con compatibilidad electromagnética EMC. El principio modular permite combinar distintos componentes estándar en función de la demanda. El resultado son subracks basados en las especificaciones del cliente o envolventes normalizados de 19 pulgadas.

Las placas frontales personalizables para tarjetas normalizadas europeas pueden equiparse con dispositivos adicionales, como asas de extracción, o ampliarse con una casete de protección. BOPLA ofrece subracks en tres variantes diferentes para cumplir los deseos de los clientes, también con respecto a su compatibilidad electromagnética. A diferencia del subrack Interzoll, concebido para aplicaciones básicas, los componentes de Interzoll Modul están optimizados para aplicaciones complejas y con apantallado EMC. Las cajas Interzoll Plus, concebidas como envolvente de 19 para sobremesa, permiten gracias a sus dimensiones normalizadas la integración en sistemas con poco espacio disponible. Y la caja especial Interzoll Case con una anchura estándar de 19 pulgadas brinda a los técnicos de desarrollo más espacio para el montaje de tarjetas PCB en posición horizontal si se precisan productos finales de baja altura.

Internorm Stil es una caja de sobremesa para uso independiente con conexiones integradas para conductores de protección, buen apantallado electromagnético y condiciones ideales de ventilación. La serie Intertego da un paso más adelante en cuestión de diseño y flexibilidad. Por un lado, es posible el uso como solución independiente o la integración como subrack en diferentes entornos. Por otro lado, las cajas metálicas permiten una configuración invididual con tres alturas, tres anchuras y tres profundidades diferentes. El sistema de cajas modulares Internorm, una de las pocas envolventes de plástico existentes hasta ahora en el mercado, ofrece además una opción alternativa a los armarios grandes para subracks con clase de protección hasta IP54. En su interior pueden integrarse hasta doce subracks estándar.

**Integración de sistemas de entrada y teclados de membrana**

BOPLA completa el paquete completo de cajas de 19 pulgadas con una amplia gama de servicios a lo largo de la cadena completa de proceso. El especialista en envolventes asiste a sus clientes ya en la fase de planificación. La empresa utiliza distintos procedimientos de fabricación y está en condiciones de atender a peticiones especiales sin recurrir a proveedores externos. En las cajas de 19 pulgadas pueden integrarse equipos especiales, como sistemas de entrada o teclados de membrana. BOPLA personaliza sus envolventes con rotulación láser, impresión serigráfica o impresión digital. El paquete completo puede incluir la dotación de los subracks con componentes e incluso un embalaje individual.

Todos estos productos gozan de una excelente aceptación en todo el mundo. En su cooperación con BOPLA, los clientes se benefician de las ventajas de la red mundial de distribución del Grupo Phoenix Mecano. Las dimensiones normalizadas hacen posible el uso de racks y sistemas modulares en diversos sectores, como la técnica de medición y regulación, en autobuses y en automóviles, proyectos de infraestructura o en el campo de la telecomunicación. La versión específica de los subracks para ferrocarril ha superado pruebas de resistencia a la vibración y satisface las exigencias de la norma de ensayo BN 411 002, que acredita su idoneidad para el uso en material ferroviario.

***Más información en:*** [***www.bopla.de***](https://www.bopla.de/)

**Acerca de Bopla Gehäuse Systeme GmbH:**

|  |
| --- |
| La empresa BOPLA, con sede en Bünde, en Westfalia oriental (Alemania), es uno de los líderes globales de la industria de cajas y envolventes. BOPLA desarrolla y produce desde hace más de 50 años cajas específicas de plástico y de aluminio para equipos electrónicos, así como unidades de entrada basadas en pantallas táctiles y teclados de membrana. Desde el año 1977, la empresa forma parte del grupo suizo con ámbito de operación global Phoenix Mecano AG. Las cajas y envolventes específicas de BOPLA se utilizan, entre otras aplicaciones específicas, en la técnica de medición, control y regulación, en la fabricación de máquinas e instalaciones, en la técnica médica y en la técnica ferroviaria. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Personas de contacto para periodistas:** |  |
| Sebastian Deppe  Sputnik GmbH  Prensa y relaciones públicas  Hafenweg 9  48155 Münster  Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-243  [deppe@sputnik-agentur.de](mailto:deppe@sputnik-agentur.de)  [www.sputnik-agentur.de](http://www.sputnik-agentur.de)H | Lukas Schenk  Sputnik GmbH  Prensa y relaciones públicas  Hafenweg 9  48155 Münster  Tel.: +49 (0) 2 51 / 62 55 61-131  [schenk@sputnik-agentur.de](mailto:schenk@sputnik-agentur.de)  www.sputnik-agentur.dehttps://www.sputnik-agentur.de |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |